

檔 號：

保存年限：

台中市電腦商業同業公會 函

地址：台中市昌平路一段 95-8 號 9 樓

承辦人：許富豪

電話：(04)22421717#235

傳真：(04)22421030

電子郵件：cody@tcca.org.tw

受文者：台灣半導體產業協會

發文日期：中華民國 114 年 11 月 19 日

發文字號：中市電總字第 1140000230 號

速別：普通

密等及解密條件：

附件：活動 DM

主旨：本會擬辦理經濟部產業發展署 114 年度「智慧製造 AI 人才培訓計畫」課程，敬請協助邀約貴會之區內廠商踴躍報名參加。檢送聯合課程 DM 一式(如附件)，請查照。

說明：

一、面對美國關稅調整與國際情勢變動，產業正迎來轉型關鍵時刻！為協助企業強化經濟韌性，經濟部產業發展署特別推出 AI 應用實作培訓系列課程，以「實作演練」取代理論教學，實際操作 AI 工具，讓 AI 真正落地工作場域，解決現場問題。

二、本次聯合招生課程詳細資訊如下：

(一) 高雄場－「半導體高階封裝 AI 趨勢與應用」

內容涵蓋 2.5D/3D 封裝、TSV 技術、異質整合架構、封裝製程挑戰及 AI 於封裝製程數據分析、缺陷預測與參數最佳化之應用，並結合失效分析與量測實作。

● 授課時間：12/8(一)~12/11(四) 9:00~17:00

● 授課地點：國立高雄科技大學(高雄市三民區建工路 415 號)

(二) 台南場－「熱門 AI 視覺工具應用實戰班：基礎圖像與視覺 AI 工具實作演練」

自傳統影像處理 (OpenCV) 入門，進一步結合機器學習分類器、YOLO 物件偵測及 Google MediaPipe 視覺框架，帶領學員完成從影像前處理、特徵提取、模型訓練到人機互動應用開發的實務流程。

● 授課時間：12/10(三)、12/11(四)、12/17(三)、12/18(四) 9:00~17:00

● 授課地點：南臺科技大學(台南市永康區南台街 1 號)

(三) 台中場—「AI 瑕疵檢測與製程監控應用班」

從智慧感測與維護檢測邏輯，結合資料處理、時序數據分析與 AI 模型建置，資料雲端串接，建置製程瑕疵檢測與設備狀態監控模型，強化工廠即時監控與異常預警能力，提升良率與稼動率。

● 授課時間：12/10(三)、12/11(四)、12/16(二)、12/24(三)
9:00~17:00

● 授課地點：逢甲大學(台中市西屯區文華路 100 號)

(四) 台北場—「從智慧人機互動驅動數據分析、生成與加值」

運用生成式 AI 與程式進行數據分析、內容生成與價值賦予，強調對 AI 輸出的批判性思維與責任意識，將運動數據、使用者行為資料等轉化為具敘事性與互動性的創新應用。

● 授課時間：12/9(二)、12/15(一)、12/22(一)、12/23(二)
8:30~12:30 與 12/10(三)、12/24(三) 8:30~17:30

● 授課地點：國立臺北科技大學(台北市大安區忠孝東路三段 1 號)

三、 本系列課程全額免費名額有限，如額滿將以製造業在職從業人員優先錄取。報名資格、報名截止日期及交通資訊等，請線上報名系統說明辦理(<https://reurl.cc/R9jQAx>)。如有活動相關疑問，請聯絡承辦人員許先生。

四、 檢附本次活動 DM 一式。

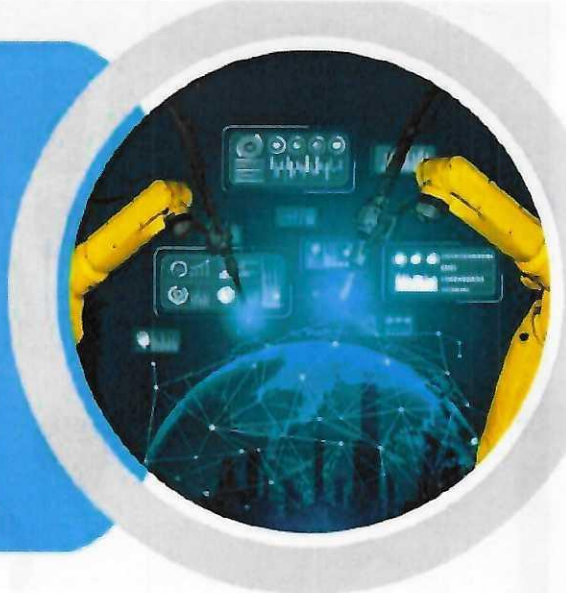
正本：台灣半導體產業協會

副本：台中市電腦商業同業公會

理事長 李國榮

AI 應用實戰班

好評加開~即日起開放報名！
請把握機會，帶領企業升級AI實力
迎戰全球新局勢！



課程1

半導體高階封裝AI趨勢與應用

AI智慧與封裝技術，搶攻產業先機

● 高雄科技大學
(高雄市三民區建工路415號)

● 12/8~12/11 9:00~17:00



課程3

AI瑕疵檢測與製程監控應用班

資料流-雲端模型應用情境完整鏈結

● 逢甲大學
(臺中市西屯區文華路100號)

● 12/10、12/11、12/16、12/24
9:00~17:00



課程2

熱門AI視覺工具應用實戰班： 基礎圖像與視覺AI工具實作演練

從OPENCV到YOLO，實戰AI視覺力

● 南臺科技大學
(臺南市永康區南台街1號)

● 12/10、12/11、12/17、12/18
9:00~17:00



課程4

從智慧人機互動驅動數據分析、 生成與加值

掌握人機互動核心，實現AI價值落地

● 臺北科技大學
(臺北市大安區忠孝東路三段1號)

● 12/9、12/15、12/22、12/23
8:30~12:30
12/10、12/24 8:30~17:30



培訓對象

製造業與自動化產線相關工程師、設備與
品質管理人員、研發技術人員及對智慧製造
有興趣之企業人士

(名額有限，如額滿將以製造業在職從業人員優先錄取)



立即掃描
QRcode報名
開班人數各25人



AI應用實戰課程 打造企業轉型新動能！

面對美國關稅調整與國際情勢變動，產業正迎來轉型關鍵時刻！為協助企業強化經濟韌性，經濟部產業發展署特別推出AI應用實作培訓系列課程，結合學界專業師資與產業實務案例，以「實作演練」取代理論教學，幫助學員實際操作AI工具，讓AI真正落地工作場域，解決現場問題。

課程特色

- ✓ 打破理論框架，實作演練助您應用到產線
- ✓ 在職進修政府來助力，參與課程完全免費
- ✓ 為智慧製造有興趣者，打造未來工業新舞台！

好評加開！
請把握機會
立即掃描QRcode報名



☎ 04-22421717#242 黃小姐
✉ eva@tcca.org.tw

主辦單位 | 經濟部產業發展署 執行單位 | 台北市電腦商業同業公會 協辦單位 | 台中市電腦商業同業公會
合作單位 | 國立高雄科技大學 / 南臺科技大學智慧製造科技中心 / 逢甲大學 / 國立臺北科技大學

AI 應用實戰班

半導體高階封裝AI趨勢與應用

2.5D/3D 工程師制霸班!
AI 缺陷預測 x 異質整合實戰解鎖



📍 高雄科技大學(高雄市三民區建工路415號)

實作課程 12/8(一)~12/11(四) 09:00~17:00

✨ 課程關鍵特色

- ✓ 掌握 2.5D/3D 前瞻封裝技術 與異質整合架構
- ✓ 實戰 AI 數據缺陷預測，打造主動預防的品管新模式
- ✓ 以 AI 驅動參數最佳化，培養熱管理與跨模組整合的解決能力
- ✓ 掌握電性量測、SEM與TSV製程的關鍵實務技術

適合對象：

- 工程師、技術人員、有志投入半導體製造、封裝、測試與材料領域之企業人士

(名額有限，如額滿將以製造業在職從業人員優先錄取)



立即掃描QRCODE報名

開班人數**25**人
政府補助課程
完全免費



☎ 04-2242-1717 #242 黃小姐

✉ eva@tcca.org.tw

主辦單位 | 經濟部產業發展署 執行單位 | 台北市電腦商業同業公會 協辦單位 | 台中市電腦商業同業公會 合作單位 | 國立高雄科技大學